

SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距，浮动端子， FSB5系列

molex

SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供灵活性，适用于汽车、工业和消费类等许多产品。

FSB5系列是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。FSB5系列连接器应用广泛，支持高温和高速传输。Molex Micro Solution团队的设计可满足任何市场需求。



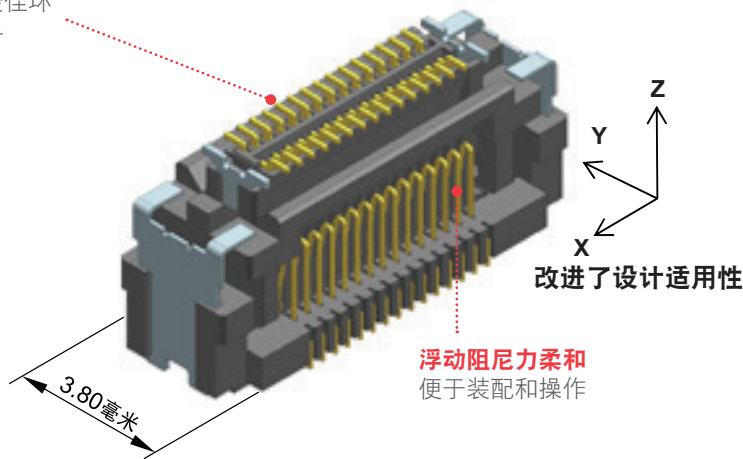
特点和优点

低卤素
选用最佳环保材料

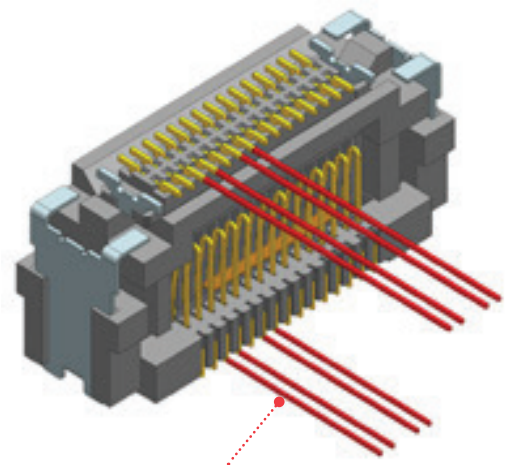
在XYZ方向上的浮动范围均为±0.5毫米

在未对准或盲配情况下补偿偏移，便于插配

可耐受高达125摄氏度的高温
改进了设计适用性



是尺寸最小的浮动端子板对板连接器
节省空间



高速传输
支持6 Gbps高速传输速率

*引脚分配: GSSGSSG

应用场合

汽车

- 汽车摄像头
- 汽车雷达
- 汽车激光雷达
- 汽车信息娱乐系统

工业

- 自动化机械
- 变压器

消费类产品

- 无人机



车载摄像头



汽车雷达



自动化机械

SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距，浮动端子， FSB5系列

molex

产品规格

参考信息

包装：器件承载卷带
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤：低卤素

电气参数

电压（最大值）：40伏
电流（最大值）：每路0.3安
接触电阻（最大值）：80毫欧
绝缘耐压：250伏交流
绝缘电阻（最小值）：100兆欧

机械参数

插入力：参见规范
拔脱力：参见规范
可插拔次数（最大值）：30次

物理参数

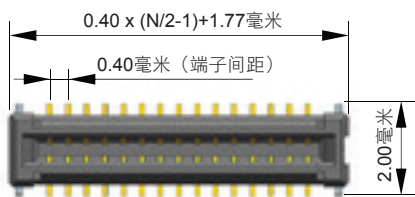
外壳：LCP, UL 94V-0, 黑色
接点：铜合金
固定脚：铜合金
电镀：
接点部位 - 镀金
焊尾部位 - 镀锡
底层电镀 - 镀镍
工作温度：-40至+125摄氏度

外形尺寸

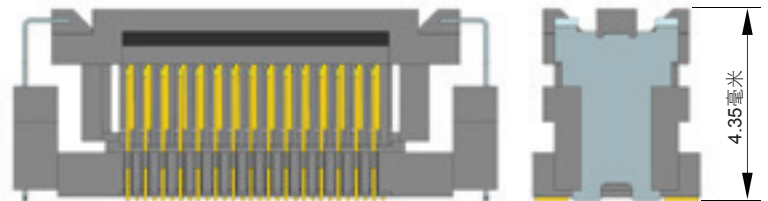
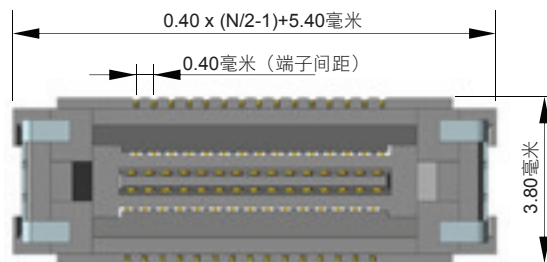
欲知详细尺寸，请参阅图纸

N：电路数量

插座



插头



订购信息

订购号		对配高度 (毫米)	对配宽度 (毫米)	电路数量
插座	插头			
203955-0**1	203956-0**1	5.00	3.80	20, 30, 40, 50, 60

**：电路数量

www.molex.com/link/slimstack.html
www.chinese.molex.com/link/slimstack.html

MOLEX是MOLEX有限责任公司在美国的注册商标，可能已在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均归其各自所有者所有。